

【PPT】关注IC封装基板“小巨人”普诺威，储能BMS行业先行者科工电子--开源北交所

作者 | 开源证券研究所--北交所研究中心



· 新三板筑牢“塔基”与交易所共同服务中小企业，累计输送880家上市公司

中国资本市场已形成了包括沪深主板、科创板、创业板、北交所、新三板以及区域性股权交易市场等在内的多层次市场体系，呈现出明显的递进结构与差异化定位。全国中小企业股份转让系统（“新三板”）是中国多层次资本市场的重要组成部分，为众多中小企业提供挂牌展示、股权融资等服务。截至2026年4月17日，新三板合计向沪深北及港交所共计输送880家企业。

· 新三板本周新挂牌2家，关注普诺威、科工电子

本周（2026.4.13~2026.4.19），新增2家挂牌公司。2024年营收均值3.67亿元，归母净利润均值5999.62万元。

1、普诺威（875148.NQ）：IC封装基板“小巨人”，主要产品包括MEMS 封装基板、射频（RF）类封装基板、SiP封装基板等，广泛应用于消费电子、智能家居、通讯、新能源汽车、AIoT、医疗健康等领域。与歌尔微、瑞声科技、英飞凌等全球主流MEMS 声学器件厂商建立了稳固的合作关系。公司第一大股东崇达技术（002815.SZ）直接持有公司47.79%的股权。根据Prismark统计数据，全球IC封装基板产值预计2025-2029年复合增速为7.05%。

2、科工电子（874963.NQ）：国内储能BMS行业先行者，公司专注于技术含量较高的大储（发电侧电网侧储能、独立储能）BMS产品，技术路线覆盖锂电池（磷酸铁锂、钛酸锂、三元锂、半固态锂电池等）、钠电池、液流电池（全钒、锌溴、铁铬、水系有机）、超级电容等多种新型储能技术路线。董事长、总经理刘爱华具备丰富行业经验。根据GGII（高工产业研究院）发布的《2024年中国第三方储能BMS企业出货量排名》，公司BMS出货量排名第三，亦是公司连续第三年排名行业前三。

· 下周2家公司上会，本周维卓致远、芯愿景、信联电科3家企业报送辅导

下周（2026.4.20-2026.4.24）将有2家公司北交所上会，分别是凯达重工、益坤电气。截至2026年4月19日，共有38家公司过会待北交所上市。本周3家挂牌公司报送上市辅导，均目标北交所上市。分别是维卓致远、芯愿景、信联电科。

· 市场动态：恒宝通、中欣晶圆、云岭光电本周成交金额居前

当前新三板挂牌企业5910家。其中创新层2259家，基础层3651家。本周触及股票交易异常波动58起，共发生大宗交易59起，琥珀股份、凯琦佳、雅港复材交易金额居前；披露4起特定事项协议转让公开信息。5家公司新增/更新定增预案，1家公司实施募集5000万元。截至2026年3月31日，新三板挂牌公司总市值26109.54亿元，环比增加253.19亿元，市盈率17.88倍。2026年3月合计成交金额52.45亿元。截至2026年4月19日，2026年新三板定增募资14.45亿元，2026年4月募资0.87亿元。本周成交金额前十名的挂牌公司分别为：恒宝通、中欣晶圆、云岭光电、英派瑞、亚锦科技、四维文化、恒神股份、凯琦佳、蓝耘科技、粤开证券。

风险提示：数据统计有误风险、数据统计滞后风险、宏观经济波动风险



详细内容



新三板掘金周报
第十八期

关注IC封装基板“小巨人”普诺威
储能BMS行业先行者科工电子

姓名 诸海滨（分析师）

证书编号：S0790522080007

邮箱：zhuhaibin@kysec.cn

2026年 04 月 27 日

核心观点

新三板筑牢“塔基”与交易所共同服务中小企业，累计输送880家上市公司

中国资本市场已形成了包括沪深主板、科创板、创业板、北交所、新三板以及区域性股权交易市场等在内的多层次市场体系，呈现出明显的递进结构与差异化定位。全国中小企业股份转让系统（“新三板”）是中国多层次资本市场的重要组成部分，为众多中小企业提供挂牌展示、股权融资等服务，截至2026年4月17日，新三板合计向沪深北及港交所共计输送880家企业。

新三板本周新挂牌2家，关注普诺威、科工电子

本周（2026.4.13~2026.4.19），新增2家挂牌公司。2024年营收均值3.67亿元，归母净利润均值5999.62万元。

1、普诺威（875148.NQ）：IC封装基板“小巨人”，主要产品包括 MEMS 封装基板、射频（RF）类封装基板、SiP 封装基板等，广泛应用于消费电子、智能家居、通讯、新能源汽车、AIoT、医疗健康等领域。与歌尔微、瑞声科技、英飞凌等全球主流 MEMS 声学器件厂商建立了稳固的合作关系。公司第一大股东荣达技术（002815.SZ）直接持有公司47.79%的股权。根据 Prismark 统计数据，全球IC封装基板产值预计2025-2029 年复合增速为7.05%。

2、科工电子（874963.NQ）：国内储能BMS 行业先行者，公司专注于技术含量较高的大储（发电侧电网侧储能，独立储能）BMS 产品，技术路线覆盖锂电池（磷酸铁锂、钛酸锂、三元锂、半固态锂电池等）、钠电池、液流电池（全钒、锌溴、铁铬、水系有机）、超级电容等多种新型储能技术路线。董事长、总经理刘爱华具备丰富行业经验。根据 GGII（高工产业研究院）发布的 2024 年中国第三方储能BMS 企业出货量排名，公司 BMS 出货量排名第三，亦是公司连续第三年排名行业前三。

下周2家公司上会，本周维卓致远、芯愿景、信联电科3家企业报送辅导

下周（2026.4.20~2026.4.24）将有2家公司北交所上会，分别是凯达重工、益坤电气。截至2026年4月19日，共有38家公司过会待北交所上市。

本周3家挂牌公司报送上市辅导，均目标北交所上市。分别是维卓致远、芯愿景、信联电科。

市场动态：恒宝通、中欣晶圆、云岭光电本周成交金额居前

当前新三板挂牌企业5910家，其中创新层2259家，基础层3651家。本周触及股票交易异常波动58起，共发生大宗交易59起，琥珀股份、凯琦佳、雅漫复材交易金额居前；披露4起特定事项协议转让公开信息。5家公司新增/更新定增预案，1家公司实施募集5000万元。截至2026年3月31日，新三板挂牌公司总市值26109.54亿元，环比增加253.19亿元，市盈率17.88倍。2026年3月合计成交金额52.45亿元。截至2026年4月19日，2026年新三板定增募资14.45亿元，2026年4月募资0.87亿元。本周成交金额前十名的挂牌公司分别为：恒宝通、中欣晶圆、云岭光电、英派瑞、亚锦科技、四维文化、恒神股份、凯琦佳、蓝耘科技、粤开证券。

风险提示：数据统计有误风险、数据统计滞后风险、宏观经济波动风险

KYSEC

目录

CONTENTS

1

新挂牌公司2家，可关注普诺威、科工电子

2

发行上市动态：下周2家公司上会

3

上市辅导：维卓致远、芯愿景、信联电科3家企业辅导

4

市场情况及信息披露：本周共发生4起协议转让

5

市场数据：恒宝通、中欣晶圆、云岭光电成交金额居前

KYSEC

目录
CONTENTS



塔基效应，累计向市场输送880家上市公司



风险提示

KYSEC

1

新挂牌公司2家，可关注普诺威、科工电子

本周（2026.4.13~2026.4.19），新增2家挂牌公司。2024年营收均值3.67亿元，归母净利润均值5999.62万元。可关注普诺威（IC封装基板“小巨人”）、科工电子（国内储能BMS行业先行者）。

表：2026.4.13~2026.4.19新增挂牌公司2家，可关注普诺威、科工电子

序号	证券代码	证券简称	持续督导主办券商	总营收 (万元)	归母净利润 (万元)	所属 省份	所属 城市	主营产品
1	875148	普诺威	中信建投证券	52,629.97	6,701.89	江苏省	昆山市	电子设备及加工、封装基板
2	874963	科工电子	中信建投证券	20,869.91	5,297.35	浙江省	杭州市	储能BMS产品

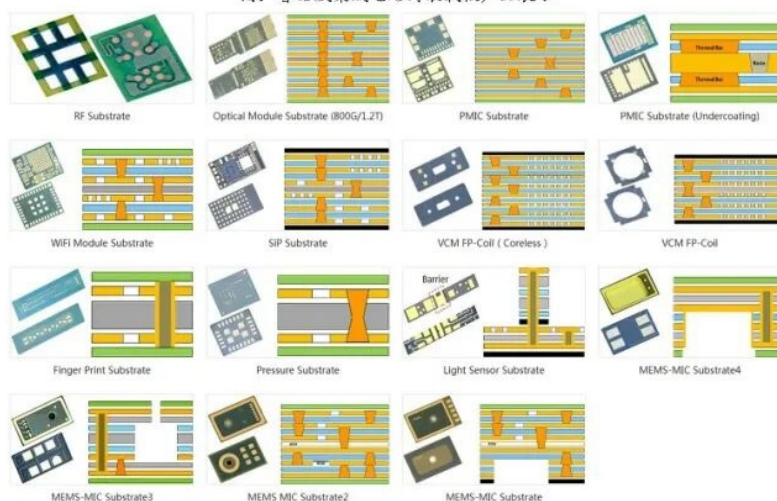
KYSEC

数据来源：Wind、开源证券研究所（注：总营收、净利润为2024年数据）

1.1 普诺威：IC封装基板“小巨人”

江苏普诺威电子股份有限公司专注于 IC 封装基板的研发、生产和销售，为全球客户提供多元化、高可靠性的 IC 封装解决方案。公司主要产品包括 MEMS 封装基板、射频（RF）类封装基板、SiP 封装基板等，广泛应用于消费电子、智能家居、通讯、新能源汽车、AIoT、医疗健康等领域。

图：普诺威集成电路封装基板产品展示



KYSEC

资料来源：普诺威官网

1.1 普诺威三大产品类别

表：普诺威拥有MEMS 封装基板、射频（RF）类封装基板、SiP 封装基板三大产品类别

产品类别	细分产品类型	相关指标	应用场景及实现功能
MEMS 封装基板	麦克风封装基板	封装工艺：WB-LGA 层数：2~6	手机、TWS 耳机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备、新能源汽车、AIoT、智能家居等 实现将声音信号转为电信号的功能
	光学传感器封装基板	封装工艺：WB-LGA 层数：2	手机、TWS 耳机、扫地机器人 实现距离感应的功能
	压力传感器封装基板	封装工艺：WB-LGA 层数：2~4	新能源汽车胎压检测、电池包压力检测、血压计、消费级无人机、AIoT 等 实现量测压力的功能
	惯性传感器封装基板	封装工艺：WB-LGA 层数：2	手机、TWS耳机、智能穿戴、新能源汽车、AIoT 实现感应加速度、倾斜、冲击、振动、旋转等功能，用于导航、定向和运动控制等。
射频（RF）类封装基板	分立器件	封装工艺：FC-LGA、WB-LGA 层数：2~12	手机、微基站、智能穿戴设备、新能源汽车、智能家居、笔记本电脑、平板电脑、AIoT 实现滤除特定频段内的信号，提高信号的抗干扰性及信噪比；将多路射频信号中的任一路或几路通过控制逻辑连通，以实现不同信号路径的切换；把天线接收到的微弱射频信号放大等
	分集模组	封装工艺：SiP（LGA） 层数：2~8	手机、微基站、智能穿戴设备、新能源汽车、智能家居、笔记本电脑、平板电脑、AIoT 实现接收射频信号的功能
	主集模组	封装工艺：SiP（LGA） 层数：2~6	手机、微基站、智能穿戴设备、新能源汽车、智能家居、笔记本电脑、平板电脑、AIoT 实现收发射频信号的功能
SiP 封装基板	WiFi 模组封装基板	封装工艺：SiP（LGA） 层数：2~4	手机、智能穿戴设备、路由器、新能源汽车、笔记本电脑、平板电脑 实现发送WiFi 信号的功能。
	RFID 电子标签封装基板	封装工艺：SiP（LGA） 层数：2~6	仓储、商超、新能源汽车 实现资产的自动识别与追踪。

KYSEC

资料来源：普诺威公开转让说明书、开源证券研究所

1.1 MEMS声学传感器封装基板龙头，全球主流声学器件厂商核心供应商

公司深耕 MEMS 封装基板领域多年，积累了深厚的技术工艺与生产管理经验，为 MEMS 声学传感器封装基板领域的龙头企业，与歌尔微、瑞声科技、英飞凌等全球主流 MEMS 声学器件厂商建立了稳固的合作关系，下游终端应用客户覆盖全球主要的头部消费电子品牌。

表：普诺威2025H1前五大客户集中度65.97%

报告期	单位名称(客户)	销售金额(万元)	占营业收入比(%)
2025 中报	歌尔微电子股份有限公司	10,664.80	40.79
	瑞声科技控股有限公司	2,863.12	10.95
	钰太科技股份有限公司	1,737.85	6.65
	Infineon Technologies Asia PacificPte Ltd	1,163.18	4.45
	苏州敏芯微电子技术股份有限公司	818.61	3.13
	合计	17,247.56	65.97
2024 年报	歌尔微电子股份有限公司	23,650.94	44.94
	钰太科技股份有限公司	5,047.92	9.59
	瑞声科技控股有限公司	4,439.00	8.43
	天水华天科技股份有限公司	3,291.18	6.25
	Infineon Technologies Asia PacificPte Ltd	3,192.19	6.07
	合计	39,621.24	75.28
2023 年报	歌尔微电子股份有限公司	13,222.39	42.49
	瑞声科技控股有限公司	5,463.92	17.56
	苏州敏芯微电子技术股份有限公司	3,064.09	9.85
	钰太科技股份有限公司	1,555.27	5.00
	天水华天科技股份有限公司	1,495.79	4.81
	合计	24,801.47	79.71

KYSEC

数据来源：Wind、开源证券研究所

1.1 掌握IC封装基板关键技术，形成自主知识产权体系，构筑坚实技术壁垒

公司以创新发展为引擎，掌握了高密度、高精度及异构集成等 IC 封装基板领域的关键技术，并形成了自主知识产权体系，构建了坚实的技术壁垒。截至国家知识产权局查询日（2025年10月28日），公司取得授权专利75项，其中发明专利61项，实用新型专利14项，并参与起草了3项国家标准和2项团体标准。

表：普诺威自主研发实现规模化生产的技术

序号	技术名称	技术特色	技术应用情况
1	高精度平面嵌入式电容电阻混压技术	高精度平面嵌入式电容电阻混压技术主要由平面嵌入式电容技术和平面嵌入式电阻技术构成。 ①平面嵌入式电容技术：选用高介电常数（DK）的超薄介质双面覆铜基板，通过双面不对称精密蚀刻工艺及高精度层间对准方案实现接地层（GND）和电容层（EC）制作，通过介质层两侧铜箔正对面积形成期望容值；同时采用双面不对称混压技术实现电容嵌入，具有减少电感、降低电磁干扰、节省布线空间、提高可靠性等优点。 ②平面嵌入式电阻技术：采用纳米级厚度薄膜电阻铜箔，通过精密蚀刻工艺控制电阻宽度和长度来实现电阻嵌入，具有减少寄生效应、提高自谐振频率、降低信号噪声、降低电磁干扰等功效。	MEMS封装基板
2	高精度平面嵌入式精密线圈技术	高精度平面嵌入式精密线圈技术主要应用于智能手机摄像头 OIS 光学防抖 VCM 马达线圈基板，受限于摄像头模组空间，同时又需要足够的推力来带动镜头或传感器移动或旋转，因此在满足一定板厚的前提下，基板设计需要实现足够的绕线匝数、绕线长度、电阻等，其特点为厚铜、薄介质、平面绕线，公司依托改良半加成法工艺（mSAP），开发出了平面嵌入式精密线圈技术，通过接收信号施加正向或反向电流，在特定磁场内形成一定的推力，带动镜头或图像传感器移动到指定的位置或角度，从而减弱手机抖动时带来的影像模糊。	SIP 封装基板
3	板级异构Cavity集成技术	板级异构Cavity集成技术主要用于 MEMS 麦克风领域，高效利用冗余空间，通过平面下沉技术在封装基板上形成 Cavity 结构，高精度尺寸及深度控制可在有限空间内实现防尘网、防水膜等封装材料嵌入，从而实现麦克风集成防尘防水功能，同时，通过开窗工艺及二氧化硅激光复合加工工艺，实现高精度Cavity 尺寸及高质量侧壁品质控制；通过高精度VCP 电镀及高精度层压工艺，提高铜层均匀性及介层均匀性，从而实现高精度Cavity 深度控制。	MEMS封装基板
4	板级异构内置空腔技术	随着用户对智能手机、智能穿戴等智能移动终端的性能要求不断提升，MEMS 麦克风不断升级，对降噪、信噪比、灵敏度等要求越来越高，传统顶部收音麦克风的后声腔容积较小，使得信噪比（SNR）表现受到局限，板级异构内置空腔技术通过高精度铆合工艺以及特殊压合工艺将多张芯板预先压合形成全埋空腔结构，表面处理后在空腔上方加工声孔结构，声孔上方放置 MEMS 芯片，声孔下方空腔结构作为后声腔，实现扩大后声腔容积，降低杂音作用，以达到更出色的拾音效果。	MEMS封装基板
5	基于半嵌入式封装的异构集成技术	随着半导体集成密度的不断提高，底部带有图形的半嵌入式封装迎来了新一轮的市场需求，广泛应用于MEMS 传感器、RF 射频前端、SIP 系统级封装等领域。基于半嵌入式封装的异构集成技术的核心流程为预先制作芯片封装用焊点图形，再使用固晶基板及盖于基板将焊点进行密封保护，表面处理前将顶部盖于去除，裸露出焊点图形进行表面处理加工，形成与芯片连接用的焊点，从而实现芯片半嵌入式封装，提高产品封装密度，实现信号隔离等功能。	MEMS 封装基板、RF 封装基板、SIP 封装基板

KYSEC

资料来源：普诺威公开转让说明书、开源证券研究所

1.1 掌握IC封装基板关键技术，形成自主知识产权体系，构筑坚实技术壁垒

表：普诺威自主研发实现规模化生产的技术

序号	技术名称	技术特色	技术应用情况
6	高密度无芯基板技术	封装基板正在加速超微型化、高密度化方向发展，如水平维度线宽/线距、垂直维度介质层厚度等。高密度无芯基板技术由无芯板结构及超薄PP 技术和表层埋线工艺技术构成。 ①无芯板结构及超薄PP 技术：无芯板结构可实现薄型化产品制作，有利于奇数层板翘曲控制，提高封装良率。层压搭配高精度设备，压机温度均匀性可控制±1℃，从而实现良好的介质均匀性及薄介质加工。薄介质使得电路传输路径减小，交流阻抗进一步减小，提高了产品性能。 ②表层埋线工艺属于无芯基板中的特殊结构，即将表层一层线路内嵌在绝缘层内，形成埋线设计；埋线面具有优良的平整度和较好的焊接基底，可提高精细线路的良率及可靠性，同时可实现比mSAP 工艺更精细的线路。	RF 封装基板，SiP 封装基板
7	基于可润湿侧翼封装的金属化半盲槽技术	随着制造技术的不断进步，汽车传感器正朝着高精度、小型化方向发展。高精度传感器能够提供更准确的数据信息，而小型化则便于传感器在各种场景下的应用部署，这将进一步提升传感器的性能和实用性。因此，传统的 lead frame（引线框架）封装方式逐渐无法满足更精密的封装需求，逐步向有机基板转移。其中，为了提高封装可靠性，可润湿侧翼技术是车载传感器封装的一大趋势。基于可润湿侧翼封装的金属化半盲槽技术，将引线框架部分功能转移至有机基板上，通过盲槽内金属选择性加工工艺，实现盲槽内金属化和非金属化组合结构，有利于车载产品自动化检验焊接效果，提高产品可靠性，同时满足封装切割品质及良率需求。	车载封装基板
8	多种表面处理SiP封装支持技术	SiP 封装是打破摩尔定律瓶颈、延续集成电路产业发展的重要技术路线之一，可实现将不同工艺、材质、功能的芯片通过先进封装技术集成在一个封装体内，不同芯片与 IC 载板的连接方式多样化，是实现集成化封装的关键所在。公司开发多种表面处理集成化技术，在同一基板上可实现分区制作不同类型表面处理，如OSP（有机可焊性保护层）搭配化金、电镀软金或镍钎金等组合，满足产品兼容Wire Bonding（打线）、Flip Chip（倒装）、焊接等功能，提高产品集成程度及可靠性。	RF 封装基板，SiP 封装基板 车载封装基板

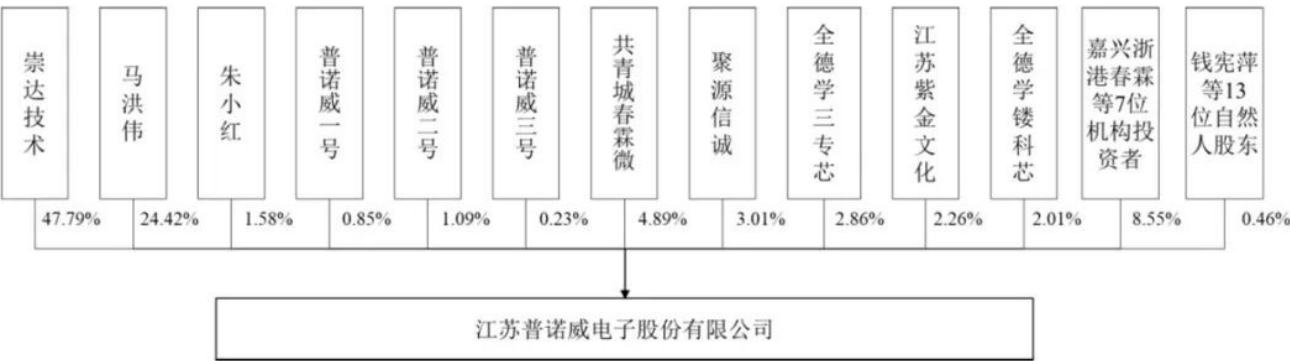
KYSEC

资料来源：普诺威公开转让说明书、开源证券研究所

1.1 崇达技术为第一大股东，持股47.79%

截至2025年12月19日，公司第一大股东崇达技术（002815.SZ）直接持有公司47.79%的股权，依其持有的股份所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，为公司的控股股东。

图：普诺威股权结构中有多个机构投资者，第一大股东为崇达技术



KYSEC

资料来源：普诺威公开转让说明书（注：数据截至2025.12.19）

1.1 IC封装基板与PCB：电子电路连接的关键载体

宏观意义上的电子封装由电子封装与电子装联/组装共同构成，而IC封装基板与PCB作为这一体系中电子电路连接的关键载体，在核心功能、技术原理、应用场景、性能要求、线路密度、基材选择、成本与市场规模等方面既存在紧密联系，又有显著区别。从联系来看，IC封装基板与PCB均为电子电路连接的关键载体，都是通过线路布局实现电子元件间的信号传输与电气连接，且IC封装基板需与PCB配合使用：IC芯片先封装在基板上，再通过基板与PCB对接，形成完整的电路系统，共同支撑电子产品的功能实现。

图：电子封装示意图，IC封装基板与PCB的应用场景差异



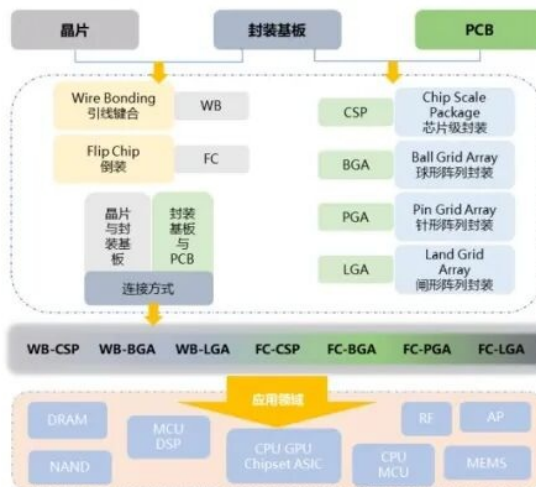
KYSEC

资料来源：普诺威公开转让说明书

1.1 公司产品覆盖各类IC封装基板，满足多元封装需求

IC封装基板根据封装形式主要可分为用于CSP芯片级封装、BGA球形阵列封装、PGA针形阵列封装和LGA栅形阵列封装等类型的基板。封装基板与晶片的连接方式主要包含WB引线键合和FC倒装两种。因此，根据封装基板与晶片和印制电路板之间的连接或封装方式，可将封装基板分为WB-CSP、WB-BGA、WB-LGA、FC-CSP、FC-BGA、FC-PGA和FC-LGA等类别。

图：IC封装基板按连接方式划分的分类



KYSEC

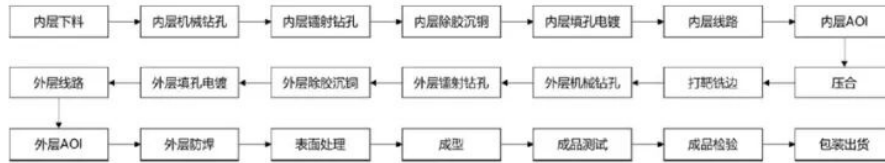
资料来源：普诺威公开转让说明书

1.1 IC封装基板三大主流工艺

IC 封装基板生产工艺分为减成法（Tenting）、加成法（SAP）和改良型半加成法（mSAP）。公司目前掌握了减成法（Tenting）和改良型半加成法（mSAP）两种工艺的生产能力。

图：普诺威目前掌握了减成法（Tenting）和改良型半加成法（mSAP）两种工艺的生产能力

①Tenting 工艺



②mSAP 工艺



KYSEC

资料来源：普诺威公开转让说明书

1.1 IC 封装基板生产工艺的三种方法

表：IC 封装基板生产工艺的三种方法

生产工艺	工艺原理及特点
减成法 (Tenting)	Tenting 工艺是出现较早且应用较为广泛、成熟的生产工艺，一般应用于线宽/线距 30/30 μm 以上的 IC 封装基板产品。主要工艺原理是通过蚀刻等方法去除覆铜板表面多余的铜以获得所需要的导电线路。化学蚀刻在垂直向下蚀刻的同时会向两端蚀刻形成侧蚀现象，造成线路的底部宽度大于顶部。由于蚀刻的精度难以控制，线宽/线距越小，使用Tenting 工艺生产的难度越高，良率亦会降低。
改良型半加成法 (mSAP)	mSAP 全称是 modified Semi-Additive Process，改良型半加成法，mSAP 工艺原理是采用超薄铜作为种子层的覆铜基板，贴覆感光抗蚀材料，经曝光显影后，将不需要电镀的区域保护起来，裸露出的区域进行电镀，退膜后，使用闪蚀将多余的种子层去除，留下来的就是需要的铜层线路。由于一开始电镀的铜层很薄，闪蚀的时间很短，因此侧蚀造成的影响就很小。相比于减成法和半加成法，改良型半加成法工艺在制造精度与加成法相差不大的情况下，生产良率大幅提高，生产成本明显下降，是目前精细线路载板主流的制造方法。
加成法 (SAP)	SAP 全称是Semi-Additive Process，半加成法，SAP 工艺原理与mSAP 工艺相似，主要区别在于 mSAP 工艺直接在基材上的铜箔上电镀加厚所需要的线路，而SAP 工艺直接在ABF 材料上的超薄化学铜涂层或物理沉积涂层进行电镀加厚所需要的线路。该工艺由于后期的蚀刻量低于 mSAP 工艺，可以达到很高的精度，最小线宽可以达到15 μm 以下。目前该方法对基材和工艺流程要求很高，成本更高，产量不大。

KYSEC

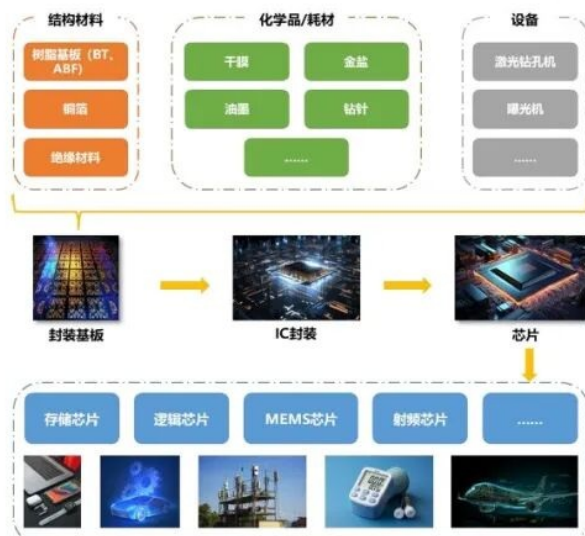
资料来源：普诺威公开转让说明书、开源证券研究所

1.1 公司卡位产业链核心（中游制造），受益于国产替代与下游高端化趋势

IC 封装基板上游主要包括树脂、铜箔、绝缘材料、干膜、油墨、金盐、钻头等材料，以及激光钻孔机、曝光机等生产设备；中游为封装基板的制造，是产业链的核心。下游主要用于存储芯片、逻辑芯片、MEMS 芯片、射频芯片等各类芯片封装，最终广泛应用于消费电子、通信设备、汽车电子、工业控制及航空航天等终端电子产品。

目前，上游高端材料、核心设备仍以日本、中国台湾企业为主导，国内企业逐步实现自主生产；下游需求驱动基板向高集成度、高频高速、耐高温方向发展，促使中游制造环节工艺不断创新升级。

图：IC封装基板产业链
IC封装基板产业链概况



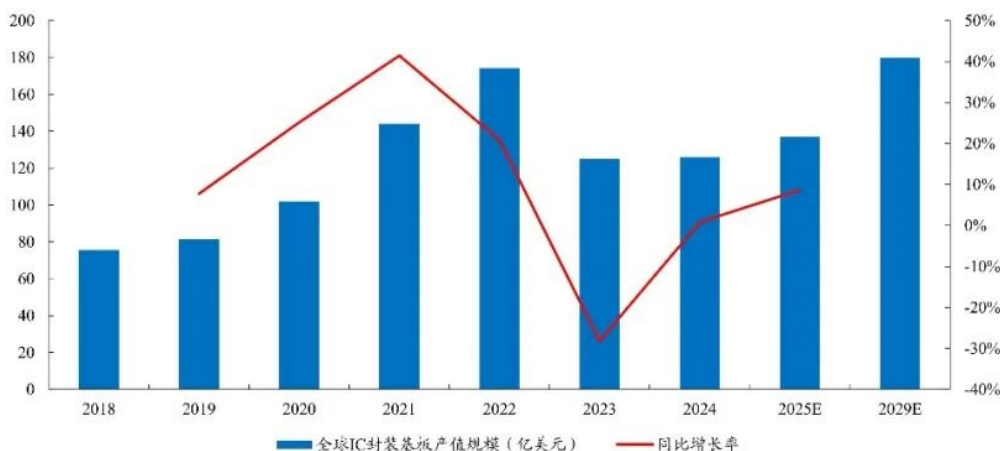
KYSEC

资料来源：普诺威公开转让说明书

1.1 供需趋于平衡，2024年产值恢复增长，行业进入上行通道

由于供需关系的变化，近几年全球 IC 封装基板产值出现显著波动。2024 年以来，随着全球半导体行业去库存结束、消费电子行业复苏、大尺寸先进封装需求的上升，封装基板行业的供需逐渐趋于平衡，全球封装基板产值恢复上涨态势。根据 Prismark 统计数据，2024 年全球 IC 封装基板产值为 126.02 亿美元，预计2025 年将继续增长8.68%，达到136.96 亿美元；同时，基于全球半导体行业的增长趋势，2029 年全球IC 封装基板产值有望达到 179.85 亿美元，2025-2029 年复合增速为7.05%。

图：全球IC封装基板产值预计2025-2029 年复合增速为7.05%



KYSEC

数据来源：Prismark、印制电路资讯、开源证券研究所

1.2 科工电子：国内储能BMS 行业先行者

杭州科工电子科技股份有限公司是国内储能BMS 行业的先行者，专注于发电侧/电网侧储能、独立储能等大型储能领域BMS产品的研发、生产和技术服务，面向新能源产业提供高度感知、精准计算、智能控制的新型储能电池管理系统相关产品，连续多年在第三方储能 BMS 领域排名前列。按照储能电池系统的三级管理架构，公司储能BMS产品还可进一步分为BMU、BCMU及 BAMS三级产品。

图：科工电子产品展示



KYSEC

资料来源：科工电子公开转让说明书

1.2 公司专注大储BMS产品，客户涵盖南方电网、国家电网、国能投央企巨头

公司专注于技术含量较高的大储（发电侧电网侧储能、独立储能）BMS 产品，主要客户包括南方电网、国家电网、国家能源投资集团、国家电力投资集团、中国电气装备集团、威腾电气、南都电源、威胜能源、明阳智能、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、格力钛新能源、清陶能源等储能集成厂商、电池企业等客户。

公司技术路线覆盖锂电池（磷酸铁锂、钛酸锂、三元锂、半固态锂电池等）、钠电池、液流电池（全钒、锌溴、铁铬、水系有机）、超级电容等多种新型储能技术路线。

表：2024年科工电子前五大客户集中度32.83%

报告期	单位名称(客户)	销售金额(万元)	占营业收入比(%)
2024 年报	威腾电气集团股份有限公司	1,625.93	7.79
	浙江南都电源动力股份有限公司	1,536.93	7.36
	江苏德春电力科技股份有限公司	1,431.81	6.86
	宁夏宝丰能源科技有限公司	1,156.29	5.54
	珠海格力电器股份有限公司	1,102.85	5.28
	合计	6,853.80	32.83
2023 年报	浙江南都电源动力股份有限公司	6,344.95	33.02
	昆宇电源股份有限公司	1,808.73	9.41
	中国电建集团海南电力设计研究院有限公司	1,309.73	6.82
	上海芯蕾新能源科技有限公司	1,262.07	6.57
	威腾电气集团股份有限公司	1,186.51	6.17
	合计	11,911.99	61.99

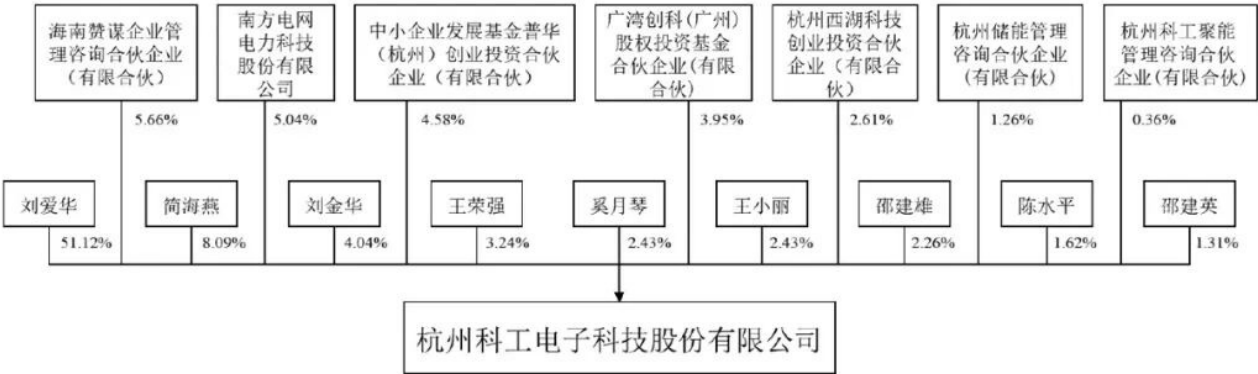
KYSEC

数据来源：wind、开源证券研究所

1.2 刘爱华直接持股51.12%，间接控制1.62%，合计52.74%，为公司控股股东

截至2025年10月23日，刘爱华直接持有公司 51.12%的股份，并通过储能咨询、聚能咨询间接控制公司 1.62%的股份，为公司的控股股东。

图：科工电子股权结构包含多家机构投资者



KYSEC

资料来源：科工电子公开转让说明书（注：数据截至2025年10月23日）

1.2 公司储能BMS出货量连续三年排名前三，市场地位稳固

根据 GGII（高工产业研究院）发布的 2024 年中国第三方储能BMS 企业出货量排名，公司 BMS 出货量排名第三，亦是公司连续第三年排名行业前三。
储能系统从技术路线、应用场景等维度存在不同的细分。

表：储能系统技术路线、应用场景划分

储能类型	技术路线	应用场景
抽水蓄能	物理储能	电网侧储能
飞轮储能		电源侧储能、电网侧储能
压缩空气储能		电源侧储能、电网侧储能
光热储能		电源侧储能、电网侧储能
锂电池储能	电化学储能	电源侧储能、电网侧储能、工商业储能、户用储能
钠电池储能		
液流电池储能		
超级电容器储能	电磁储能	电源侧储能、电网侧储能
超导储能		电源侧储能、电网侧储能

KYSEC

资料来源：科工电子公开转让说明书、开源证券研究所

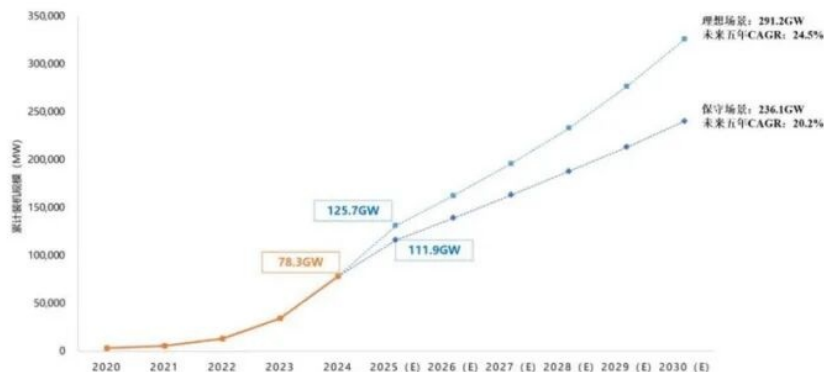
1.2 未来五年CAGR 20.2%-24.5%，2030年累计装机有望达236-291GW

根据 CNESA 统计数据，截至 2024 年末，全球新型储能市场累计装机规模约为 165.4GW，较上一年末增长 81.1%，其中锂离子电池储能市场份额 97.5%，占据绝对主导地位。

根据 CNESA 预测，2025 年国内新型储能累计装机规模将突破 100GW，预计将达到 111.9GW-125.7GW，未来五年 CAGR 将达到 20.2%-24.5%，至 2030 年累计装机规模将达到 236.1GW-291.2GW。

图：中国新型储能累计装机规模预计2025-2030年CAGR 20.2%-24.5%

中国新型储能累计装机规模预测（2025-2030 年）



KYSEC

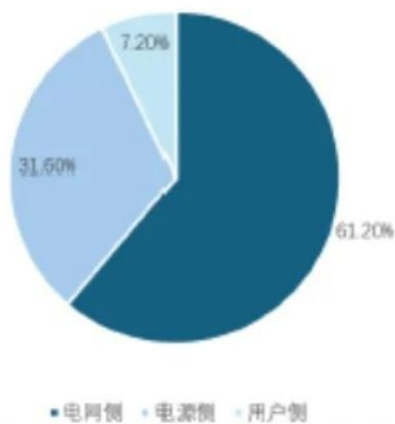
资料来源：CNESA、科工电子公开转让说明书

1.2 储能应用场景：表前储能占比92.80%，表后储能占7.2%

储能系统按应用场景可分为表前储能（电源侧/电网侧）与表后储能（用户侧）两类。根据 CNESA 统计数据，2024 年新型储能装机中表前储能（电源侧+电网侧）合计占比 92.80%，占据绝对主导地位；用户侧储能占比 7.2%，以工商业储能为主。

图：2024年新型储能装机中表前储能（电源侧+电网侧）合计占比 92.80%

2024年中国新增投运新型储能项目的应用分布情况



KYSEC

资料来源：CNESA、科工电子公开转让说明书

截至2026年4月17日，共有38家公司过会待北交所上市，其中瑞尔竞达将于4月20日上市，中科仪将于4月20日申购。
下周（2026.4.20-2026.4.24）将有2家公司上会，分别是凯达重工、益坤电气。

图：截至2026年4月17日共有38家过会公司待北交所上市，2家公司下周上会

序号	简称	更新日期	审核状态	营收 (亿元)	归母净利润 (万元)	拟募集资金 (万元)	主营业务
1	瑞尔竞达	2026/4/10	4月20日上市	4.78	9264	33,498.10	高炉功能性消耗材料(即:炼铁高炉用炮泥),高炉本体内衬(即:陶瓷杯和风口组合砖),智慧主沟,热风炉非金属炉罩子及支柱,其他不定形耐火制品(包括浇注料,捣打料,喷涂料,耐火泥浆)等
2	海昌智能	2026/4/16	待上市	10.64	15383	45,200.00	高性能线束装备的研发、生产和销售
3	鸿仕达	2026/4/14	待上市	6.64	6975	21,695.31	公司主要从事智能化设备,智能柔性生产线,配件及耗材等产品的研发、生产与销售
4	中科仪	2026/4/10	4月20日申购	12.91	84387	82,548.33	干式真空泵,真空科学仪器设备并提供相关技术服务
5	科莱瑞迪	2026/4/17	证监会注册	3.15	6404	25,913.29	肿瘤放射治疗中的放疗定位装置以及康复治疗中康复辅助器械的研发、生产和销售
6	朗信电气	2026/4/10	证监会注册	14.11	13162	35,000.00	电机总成、电子风扇、电子水泵、空调鼓风机等热管理电驱动零部件产品研发及销售
7	龙辰科技	2026/4/3	证监会注册	6.42	8555	37,544.64	主要产品分为基膜和金属化膜两大类
8	锐翔智能	2026/3/27	证监会注册	5.98	13068	48,166.10	智能制造装备、设备配件及技术服务,主要应用于消费电子,新能源汽车等行业的智能制造领域
9	嘉晨智能	2026/3/27	证监会注册	4.01	7123	26,017.63	电气控制系统产品及整体解决方案的研发、生产和销售,主要产品包括电机驱动控制系统、整机控制系统和车联网产品及应用等
10	振宏股份	2026/3/27	证监会注册	13.27	14551	45,097.50	锻造风电主轴和其他大型金属铸件
11	祺龙海洋	2026/3/20	证监会注册	3.05	6142	38,188.90	海洋钻井隔水导管的研发、生产和销售;油气长输管线的生产和销售及水下油气装备试验技术服务等
12	龙鑫智能	2026/3/20	证监会注册	6.34	11815	45,821.00	研磨设备、干燥设备及物料自动化生产线的研发、生产、销售和服务
13	新天力	2026/2/13	证监会注册	10.57	7616	39,763.79	塑料及纸制食品容器的研发、生产和销售
14	正大种业	2026/4/15	报送证监会	3.61	9075	28,326.06	主要农作物种子生产、研发、销售
15	乔路铭	2026/4/15	报送证监会	31.71	42688	65,820.17	公司产品主要为汽车内饰件、汽车外饰件及配套模具,具体分类情况如下:以立柱护板、顶棚、地毯、后围护板、门内护板、顶盖内饰板等产品为代表的内饰件;以车身装饰件、格栅、扰流板、行李架等为代表的外饰件;汽车饰件配套模具

KYSEC

数据来源:北交所官网、Wind、开源证券研究所(注:营收、归母净利润为2025年数据)

图：截至2026年4月17日共有38家过会公司待北交所上市，2家公司下周上会

序号	简称	更新日期	审核状态	营收 (亿元)	归母净利润 (万元)	拟募集资金 (万元)	主营业务
16	华汇智能	2026/4/14	报送证监会	6.16	8042	34,441.78	公司是一家专业从事高端智能装备及其关键部件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,目前已形成锂电智能装备、数控机床智能装备和精密机械部件的产品体系,其中,锂电智能装备包括研磨系统,纳米砂磨机,高效制浆机等产品;数控机床智能装备包括数控工具磨床,数控加工中心等产品;精密机械部件主要是机械密封
17	金戈新材	2026/4/10	报送证监会	5.34	5748	20,495.67	导热粉体材料,阻燃粉体材料,吸波粉体材料及其他功能材料
18	新睿电子	2026/4/10	报送证监会	3.18	5905	13,969.44	工业机器人控制系统及部件、伺服系统及部件的研发、生产和销售
19	千岸科技	2026/4/10	报送证监会	19.81	21951	48,025.80	从事自有品牌产品的研发、设计和销售,主要产品包括艺术创作,数码电子,运动户外,家居庭院等类别
20	彩客科技	2026/3/27	报送证监会	5.07	14635	21,032.57	高性能有机颜料中间体、食品添加剂中间体、光稳定剂中间体及新材料聚合单体(未来重点拓展产品)的研发、生产及销售
21	油城科技	2026/2/13	报送证监会	11.34	16479	50,000.00	公司是定位于锂电新能源行业的局部电路增值服务商,在锂电池应用化趋势背景下,围绕新能源行业的电池、电源、电驱和电动车(“四电”)关键零部件需求,专业从事第三方电池电源控制系统(BMS、PCS等)自主研发、生产及销售,并提供以集成电路、分立器件为核心的元器件应用方案
22	陈富科技	2026/2/6	报送证监会	3.46	9737	15,935.00	公司专注从事汽车流体管路系统关键零部件以及导航等其他塑料零部件的研发、生产及销售,主要包括流体管路系统快插接头,通类接头,阀类连接件,管夹等紧固件,传感器以及导航等塑料产品
23	拓普泰克	2026/2/5	报送证监会	11.32	10726	31,375.18	公司主要从事智能控制器及智能产品的研发、生产和销售,产品广泛应用于消费电子、工业自动化、信息通信、汽车电子和新能源等领域
24	美亚科技	2025/12/25	报送证监会	-	-	19,999.50	为客户提供涵盖航线票务,商旅管理和会奖旅游三大场景的数字化泛商旅出行服务
25	兢强科技	2025/12/3	报送证监会	15.77	8230	33,000.00	电磁线的设计、研发、生产及销售
26	巍特环境	2025/11/7	报送证监会	3.52	5778	16,854.31	管网检测与修复、管网智慧运营等
27	宇星股份	2024/1/24	报送证监会	4.45	4838	29,000.00	螺母
28	杨德环能	2023/10/20	报送证监会	3.67	8643	18,500.00	低浓度瓦斯综合利用业务、分布式光伏发电业务、分布式天然气供热业务
29	富印新材	2026/4/17	已审核通过	7.59	10715	40,384.99	精密功能胶粘材料,精密功能泡棉和精密功能膜材系列产品
30	双英集团	2026/4/16	已审核通过	37.43	13052	49,835.98	公司主要产品分为汽车座椅,汽车内外饰件,模具

KYSEC

数据来源:北交所官网、Wind、开源证券研究所(注:营收、归母净利润为2025年数据)

图：截至2026年4月17日共有38家过会公司待北交所上市，2家公司下周上会

序号	简称	更新日期	审核状态	营收 (亿元)	归母净利润 (万元)	拟募集资金 (万元)	主营业务
31	英氏控股	2026/4/15	已审核通过	22.21	24181	33,395.64	婴幼儿辅食、婴幼儿卫生用品、儿童食品和营养食品的开发、生产、销售、运营和服务
32	安达股份	2026/4/15	已审核通过	10.15	6954	27,957.44	汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产、销售
33	吉和昌	2026/4/15	已审核通过	5.29	6532	28,957.94	表面工程化学品(不含危险化学品)、新能源锂电池添加剂和精细化工原料(不含易燃易爆品)的生产、研发、销售及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
34	永大股份	2026/4/10	已审核通过	7.27	10938	45,781.02	压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务
35	广泰真空	2026/3/26	已审核通过	4.08	8168	16,815.18	公司是一家专注于真空装备的研发、制造和销售,并具有从设备自主设计到制造交付一体化能力的高新技术企业,公司致力于功能材料领域,尤其是稀土永磁行业,主要产品包括真空烧结炉、真空熔炼炉、真空镀膜机等真空设备
36	新富科技	2026/2/3	已审核通过	15.69	11024	40,930.57	公司主要产品为电池液冷管、电池液冷板、电控系统散热器等
37	凯达重工	2026/4/17	4月24日上会	4.77	7085	29,477.43	轧辊和辊环
38	益坤电气	2026/4/14	4月21日上会	3.73	5908	15,542.77	公司主要从事绝缘子、避雷器等过电压保护设备及在线监测设备的研发、生产及销售

KYSEC

数据来源：北交所官网、Wind、开源证券研究所（注：营收、归母净利润为2025年数据）

本周（2026.4.13~2026.4.19），3家挂牌公司报送上市辅导，均目标北交所上市。营收均值2.21亿元，中值2.48亿元；归母净利润均值3706.57万元，中值5285.77万元。

表：2026.4.13~2026.4.19维卓致远、芯愿景、信联电科3家公司报送北交所上市辅导

序号	证券代码	证券简称	方向	营业总收入 (万元)	归母净利润 (万元)	省份	城市	主营产品
1	874156	维卓致远	北证	910.10	-6,983.55	北京	北京市	医疗产品
2	874883	芯愿景	北证	24,795.22	12,817.50	北京	北京市	服务、系统集成服务
3	874723	信联电科	北证	40,612.45	5,285.77	河北省	黄骅市	化学试剂

KYSEC

数据来源：Wind、开源证券研究所（注：维卓致远为2024年财务数据，其余公司为2025年）

本周（2026.4.13~2026.4.19）触及股票交易异常波动共58起，成交金额均未超过100万元。

本周（2026.4.13~2026.4.19）共发生大宗交易59起，琥珀股份、凯琦佳、雅港新材交易金额居前。

表：2026.4.13~2026.4.19成交金额前15笔大宗交易

序号	名称	交易日期	成交价	前一交易日收盘价	当日收盘价	成交额(万元)	买方营业部	卖方营业部
1	琥珀股份	2026-04-13	13.00	14.00	14.00	1,198.99	光大证券股份有限公司北京月坛北街营业部	广发证券股份有限公司厦门湖滨南路营业部
2	凯琦佳	2026-04-17	9.00	8.00	8.00	1,197.00	浙商证券股份有限公司嘉兴梅湾街证券营业部	国投证券股份有限公司深圳光明证券营业部
3	雅港新材	2026-04-17	14.41	15.00	14.98	1,008.70	国新证券股份有限公司天津长江道证券营业部	国投证券股份有限公司北京阜成门证券营业部
4	凯琦佳	2026-04-17	6.00	8.00	8.00	798.00	浙商证券股份有限公司嘉兴梅湾街证券营业部	国投证券股份有限公司深圳光明证券营业部
5	超溢环保	2026-04-14	5.70	7.84	7.84	684.00	浙商证券股份有限公司安徽分公司	西部证券股份有限公司西安未央路第二证券营业部
6	天易成	2026-04-17	12.50	10.00	10.00	520.96	国投证券股份有限公司贵州分公司	国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部
7	深鹏科技	2026-04-15	17.35	-	17.35	500.00	东莞证券股份有限公司东莞常平分公司	中国银河证券股份有限公司东莞东城中路证券营业部
8	康安租赁	2026-04-17	0.35	0.68	0.35	469.66	中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部	中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部
9	迪赛新材	2026-04-16	19.00	27.10	27.10	323.00	南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部	国信证券股份有限公司深圳泰九分公司
10	迪赛新材	2026-04-16	19.00	27.10	27.10	323.00	南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部	中国银河证券股份有限公司中银昆山登云路证券营业部
11	微纳芯	2026-04-13	65.00	54.11	53.01	305.50	东方财富证券股份有限公司北京建国路证券营业部	国联民生证券股份有限公司国联民生证券苏州分公司
12	旭宁光电	2026-04-17	10.75	9.50	9.50	301.00	国泰海通证券股份有限公司湖南长沙五一大道第二营业部	中信建投证券股份有限公司北京大柳树路证券营业部
13	茶乾冲	2026-04-14	9.58	9.58	9.58	296.98	东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部	中国银河证券股份有限公司长兴金陵北路证券营业部
14	中欣晶圆	2026-04-13	4.50	4.60	4.64	292.50	光大证券股份有限公司上海民生路营业部	国联民生证券股份有限公司国联民生证券上海分公司
15	华创合成	2026-04-17	6.29	7.10	7.08	283.05	招商证券股份有限公司西安锦业路证券营业部	国新证券股份有限公司西安分公司

KYSEC

数据来源：Wind、开源证券研究所

本周（2026.4.13~2026.4.19）共披露4起特定事项协议转让公开信息。

表：本周（2026.4.13~2026.4.19）共披露4起特定事项协议转让公开信息

日期	代码	简称	所属层级	转让价格	成交数量(股)	转让原因
2026/4/15	831718	环球青鸟	创新层	4.25	30470267	单个受让方受让比例不低于5%
2026/4/15	835723	宝海微元	创新层	0	6000000	行政划转
2026/4/15	839573	ST瑞铂	基础层	2.95	100000	其他
2026/4/13	874647	张恒春	基础层	21.6	7634983	挂牌公司收购

KYSEC

数据来源：全国中小企业股份转让系统官网、开源证券研究所

5.1 定增：5家公司新增/更新预案，1家公司实施募集5000万元

本周（2026.4.13~2026.4.19）5家公司发布定增预案，均为确定对象的发行。1家公司完成增发，实际募资5000万元。

表：2026.4.13~2026.4.19新增/更新定增预案5家包括深蓝股份等

序号	证券代码	名称	预计募集资金(万元)	认购方式	主营产品/业务	发行对象说明
1	874936.NQ	海瑞斯	5,000.00	现金	超临界流体发泡产品的研发、生产及销售	东莞科创知识产权投资合伙企业(有限合伙), 东莞科创专精与特新股权投资合伙企业(有限合伙), 东莞松山湖招引壹号发展股权投资基金合伙企业(有限合伙), 广州创钰铭昇创业投资基金合伙企业(有限合伙), 东莞市莞台产业发展投资基金合伙企业(有限合伙), 东莞市东证宏德投资有限公司
2	872137.NQ	正泽科技	315.00	现金	信息终端设备、智能安防系统、智能仪表	南京正研企业管理合伙企业(有限合伙)
3	875136.NQ	贝斯科技	1,990.00	现金	锂离子电池的研发、设计、生产和销售	广东国恩智漫坪合私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
4	836050.NQ	深蓝股份	5,000.00	现金	空调控制器、驱动器等集成电路硬件及其相关嵌入式系统软件	浙江银轮机械股份有限公司
5	871823.NQ	天启新材	4,200.00	现金	聚氨酯树脂产品制造、销售; 电子专用材料研发、制造、销售	珠海华金领迅产业投资基金合伙企业(有限合伙), 珠海华金智尚商务咨询合伙企业(有限合伙)

表：2026.4.13~2026.4.19完成增发公司共计1家，实际募资5000万元

序号	代码	名称	发行对象	募资总额(万元)	市盈率(TTM)			主营产品/业务
					增发前	增发后	最新	
1	830843	沃迪智能	大股东	5,000.00	4.61	4.98	5.27	工业智能机器人研发与制造、自动化成套装备、智能制造创新性系统集成、数字化工厂建设

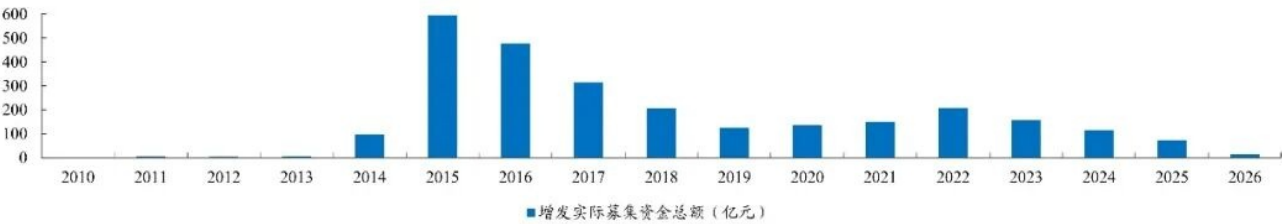
KYSEC

数据来源：Wind、开源证券研究所

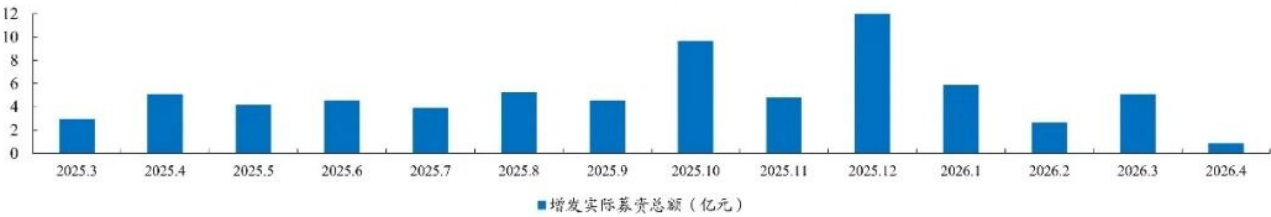
5.1 2025年定增募资72.22亿元，2026年截至4月12日仅14.45亿元

定增额度上看，新三板定增为企业带来的募资在2014-2015年间大幅增长，2015年合计定增募集额595.62亿元。随后有所下降，2019年定增募资总额125.03亿元，随着新三板深化改革，定增募资额有所回升，2022年达到207.54亿元。2025年全年合计72.22亿元。截至2026年4月19日，2026年新三板定增募资14.45亿元，2026年4月募资0.87亿元。

图：2025年新三板定增募资额合计72.22亿元，2026年当前募资14.45亿元



图：2026年4月新三板定增募资额合计0.87亿元



KYSEC

数据来源：Wind、开源证券研究所（注：数据截至2026.4.19）

5.2 恒宝通、中欣晶圆、云岭光电本周成交金额居前

本周成交金额前十名的挂牌公司分别为：恒宝通、中欣晶圆、云岭光电、英派瑞、亚锦科技、四维文化、恒神股份、凯琦佳、蓝耘科技、粤开证券。

表：恒宝通、中欣晶圆、云岭光电本周成交金额居前

序号	证券代码	证券简称	市场层级	成交均价 (元)	成交数量 (万股)	成交金额 (万元)
1	832449	恒宝通	创新层	5.83	1575.95	9183.87
2	874810	中欣晶圆	创新层	4.52	1525.93	6892.89
3	874775	云岭光电	创新层	30.18	144.66	4365.14
4	430555	英派瑞	创新层	4.43	606.64	2688
5	830806	亚锦科技	创新层	2.4	932.63	2236.47
6	430318	四维文化	创新层	3.9	559.86	2184.42
7	832397	恒神股份	基础层	1.89	1141.28	2161.41
8	875006	凯琦佳	基础层	7.5	266	1995
9	871169	蓝耘科技	创新层	19.34	95.39	1845.28
10	830899	粤开证券	基础层	0.96	1875.95	1792.94

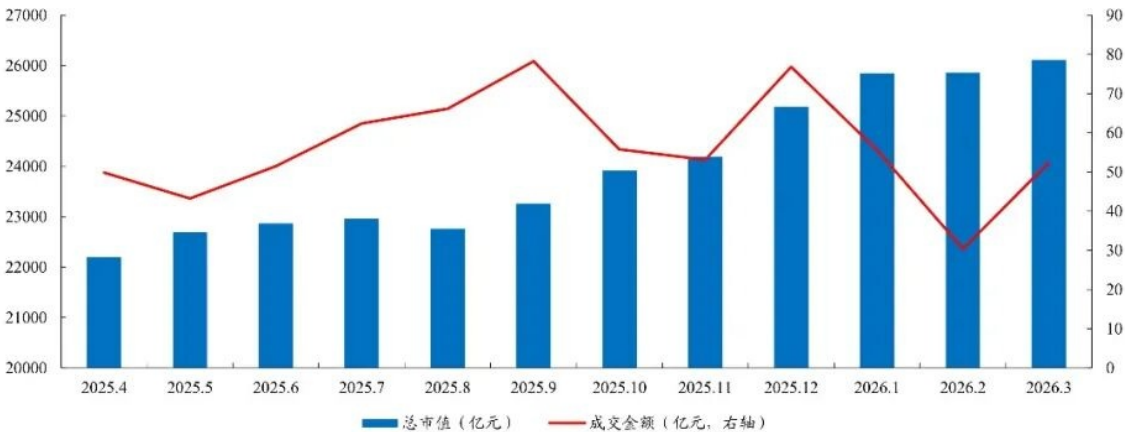
KYSEC

数据来源：全国中小企业股份转让系统官网、开源证券研究所

5.3 市值与成交额：2026年3月末挂牌公司总市值26109.54亿元

截至2026年3月31日，新三板挂牌公司总市值26109.54亿元，环比增加253.19亿元，市盈率17.88倍。2026年3月合计成交金额52.45亿元。

图：2026年3月新三板挂牌公司成交金额52.45亿元，3月末总市值26109.54亿元



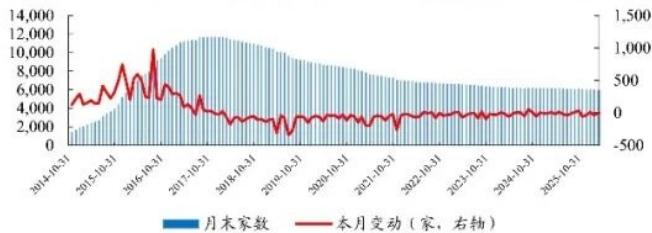
KYSEC

数据来源：全国中小企业股份转让系统官网、开源证券研究所

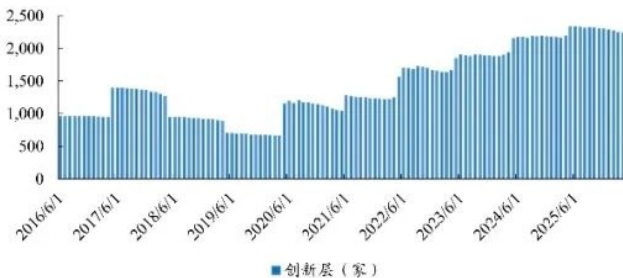
5.4 挂牌家数：2026年4月减少18家

新三板挂牌企业总数呈现先增长后逐步减少的趋势，2017年11月底达到最高点11645家，总市值50948.99亿元。2025年11月，新三板挂牌公司家数减少至6000家以内。截至2026年4月17日，新三板挂牌企业5910家。其中创新层2259家，基础层3651家。

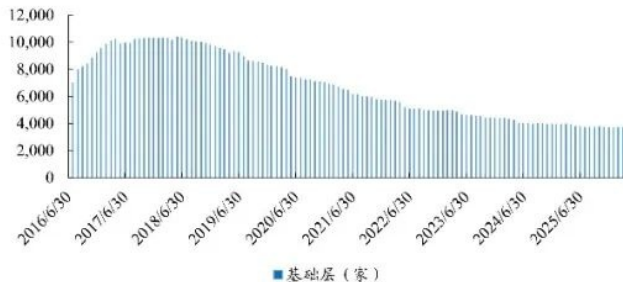
图：新三板挂牌企业总数2025年11月减少至6000家以内



图：创新层企业数量呈阶梯式上升，2020年起每年4-5月出现跃升



图：基础层公司家数在2025年11月减少至3700家以内



KYSEC

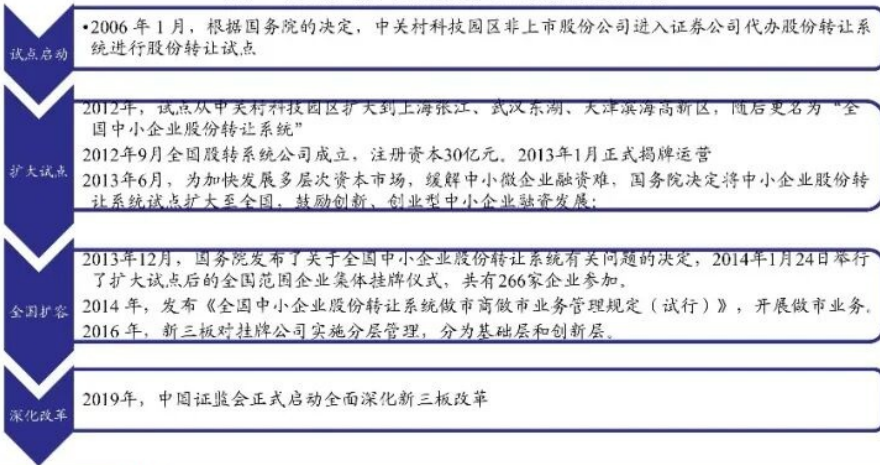
数据来源：Wind、开源证券研究所

6 中国资本市场“苗圃”：新三板以改革促发展，培育中小企业成长壮大

全国中小企业股份转让系统（“新三板”）是中国多层次资本市场的重要组成部分，通过内部分层满足不同发展阶段中小企业的融资和发展需求。

2006年1月，根据国务院的决定，中关村科技园区非上市股份公司进入证券公司代办股份转让系统进行股份转让试点，这标志着新三板的正式诞生。2019年，中国证监会正式启动全面深化新三板改革，提升市场功能，激发市场活力，补齐服务中小企业的市场“短板”。

图：“新三板”是中国多层次资本市场的重要组成部分



KYSEC

资料来源：福建省发改委官网、中国证监会官网、证券日报、股转公司官网、开源证券研究所

中国资本市场已形成了包括主板、科创板、创业板、北交所、新三板以及区域性股权交易市场等在内的多层次市场体系，呈现出明显的递进结构与差异化定位。

图：中国资本市场已形成了包括主板、科创板、创业板、北交所、新三板以及四板等在内的多层次市场体系

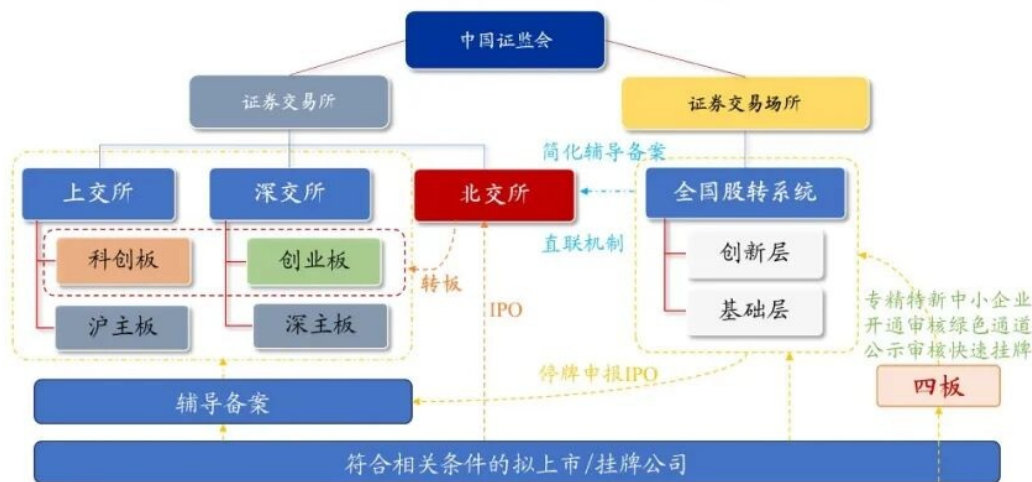
主板	科创板	创业板	北交所	新三板	新四板
- 主板上要突出大盘蓝筹特色 - 重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的成熟期优质大型企业。	- 突出“硬科技”特色，发挥资本市场改革“试验田”作用。 - 重点接纳六大行业领域（信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保）。	- 服务于成长型创新创业企业。 - 强调“三创四新”，范围更宽泛，负面清单外，符合高新技术产业企业和战略性新兴产业企业定位即可申报。	- 与全国股转系统共同打造服务创新型中小企业主阵地。 - 行业范围广泛，关注细分领域龙头企业。 - 关注培育“专精特新”企业。	针对创新型、创业型、成长型中小企业提供投融资等服务。	- 主要服务于所在省级行政区域内中小微企业的私募股权市场。 - 是地方人民政府扶持中小微企业政策措施的综合运用平台。

资料来源：中央纪委国家监委网站、中国证监会官网、各个交易所官网、人民政府官网、新华社、国务院公报、开源证券研究所

KYSEC

中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见中提出，争取经过3到5年的努力，北交所市场规模、效率、功能、活跃度、稳定性等均有显著提升，契合市场特色定位的差异化制度安排更加完善，市场活力和韧性增强，形成北交所品牌、特色和比较优势，对新三板的撬动作用日益显现；北交所与新三板层层递进、上下联动、头部反哺、底层助推的格局初步构建，服务创新型中小企业的“主阵地”效果更加明显。

图：多层次资本市场互联互通，助力新质生产力发展



KYSEC

资料来源：中国证监会官网、各个交易所官网、开源证券研究所

截至2026年4月17日，共有880家上市公司曾挂牌新三板，除北交所外，沪主板69家、深主板43家、科创板133家、创业板247家、港交所80家。

表：新三板培育的企业在各上市板块后市值Top10企业名单

代码	简称	市值（亿元）	行业	2024年营收（亿元）	2024年归母净利润（亿元）
沪主板					
601665.SH	齐鲁银行	378	银行	124.96	49.86
605589.SH	圣泉集团	327	化工	100.20	8.68
601990.SH	南京证券	326	非银金融	31.47	10.02
601399.SH	国机重装	305	机械	126.74	4.32
603516.SH	淳中科技	299	硬件设备	4.95	0.86
605376.SH	博迁新材	299	有色金属	9.45	0.87
603596.SH	伯特利	279	汽车与零配件	99.37	12.09
605196.SH	华通线缆	263	电气设备	63.47	3.19
603565.SH	中谷物流	245	交通运输	112.58	18.35
603236.SH	移远通信	222	硬件设备	185.94	5.88
深主板					
001267.SZ	汇绿生态	351	硬件设备	5.87	0.65
002929.SZ	润建股份	174	硬件设备	91.99	2.47
002181.SZ	粤传媒	159	传媒	5.97	0.30
002967.SZ	广电计量	141	企业服务	32.07	3.52
002943.SZ	宇晶股份	121	机械	10.38	-3.75
001285.SZ	瑞立科密	99	汽车与零配件	19.77	2.69
003010.SZ	芳羽臣	98	可选消费零售	17.66	1.06
003039.SZ	顺控发展	89	公用事业II	18.39	2.68
001376.SZ	百通能源	74	公用事业II	11.32	1.91
002279.SZ	久其软件	71	软件服务	40.37	-1.56

KYSEC

数据来源：wind，开源证券研究所

表：新三板培育的企业在各上市板块后市值Top10企业名单

代码	简称	市值（亿元）	行业	2024年营收（亿元）	2024年归母净利润（亿元）	代码	简称	市值（亿元）	行业	2024年营收（亿元）	2024年归母净利润（亿元）
科创板						北证					
688122.SH	西部超导	478	有色金属	46.12	8.01	920185.BJ	贝特瑞	360	有色金属	142.37	9.30
688303.SH	大全能源	477	电气设备	74.11	-27.18	920045.BJ	新东光	354	硬件设备	13.15	1.48
688180.SH	君实生物-U	462	医药生物	19.48	-12.81	920982.BJ	锦波生物	212	医药生物	14.43	7.32
688167.SH	迎光科技	349	半导体	6.20	-1.75	920808.BJ	曙光数创	164	机械	5.06	0.61
688127.SH	蓝特光学	283	硬件设备	10.34	2.21	920116.BJ	星图测控	161	软件服务	2.88	0.85
688536.SH	思瑞浦	278	半导体	12.20	-1.97	920068.BJ	天工股份	142	有色金属	8.01	1.72
688052.SH	纳芯微	276	半导体	19.60	-4.03	920029.BJ	开发科技	122	电气设备	29.33	5.89
688025.SH	杰普特	270	硬件设备	14.54	1.33	920077.BJ	吉林碳谷	107	化工	16.03	0.94
688627.SH	精智达	264	硬件设备	8.03	0.80	920493.BJ	并行科技	104	软件服务	6.55	0.12
688516.SH	奥特维	254	电气设备	91.98	12.73	920522.BJ	纳科诺尔	94	机械	10.54	1.62
创业板						港交所					
300866.SZ	安克创新	629	硬件设备	247.10	21.14	9992.HK	泡泡玛特	2134	耐用消费品	130.38	31.25
300803.SZ	指南针	607	软件服务	12.11	1.04	6969.HK	思摩尔国际	608	家电II	117.99	13.03
300748.SZ	金力永磁	454	有色金属	67.63	2.91	2696.HK	复宏汉霖	459	医药生物	57.24	8.20
301396.SZ	宏景科技	434	软件服务	6.58	-0.76	2400.HK	心动公司	316	传媒	50.12	8.12
300972.SZ	万辰集团	390	食品饮料	323.29	2.94	1797.HK	东方甄选	304	可选消费零售	65.26	17.20
300724.SZ	捷佳伟创	384	电气设备	188.87	27.64	1877.HK	君实生物	297	医药生物	19.48	-12.82
301550.SZ	斯菱股份	376	汽车与零配件	7.74	1.90	6680.HK	金力永磁	294	有色金属	67.63	2.91
300763.SZ	锦浪科技	373	电气设备	65.42	6.91	1860.HK	汇量科技	240	传媒	15.08	0.16
300832.SZ	新产业	357	医疗设备与服务	45.35	18.28	2676.HK	纳芯微	230	半导体	19.60	-4.03
300776.SZ	帝尔激光	272	硬件设备	20.14	5.28	2477.HK	经纬天地	230	软件服务	2.78	0.20

KYSEC

数据来源：wind，开源证券研究所

数据统计有误风险、数据统计滞后风险、宏观经济波动风险

KYSEC

分析师声明

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与、不与、也将不会与本报告中的具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，敬请谅解！感谢您给予的理解与配合。

股票投资评级说明

	评级	说明	备注：评级标准为以报告日后的6~12个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中A股基准指数为沪深300指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普500或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。
证券评级	买入（buy）	预计相对强于市场表现20%以上；	
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现5%~20%；	
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；	
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现5%以下。	
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；	
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；	
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。	

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

KYSEC

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及

的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼3层
邮箱：research@kysec.cn

深圳：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮箱：research@kysec.cn

北京：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层
邮箱：research@kysec.cn

西安：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮箱：research@kysec.cn

KYSEC

THANKS

感谢聆听



开源证券

特别说明

开源证券北交所研究中心是业内首个设立的专注北交所、新三板的研究中心，专注这一领域10年。深耕科技新产业、专精特新小巨人、新质生产力。首创北交所行业划分：高端制造、TMT、化工新材料、医药生物、消费与服务五大战略行业。覆盖公司广，研究跟踪久。

所获荣誉

2023-2025年新财富最佳北交所公司研究团队第一

2024-2025年Wind金牌分析师最佳北交所研究机构

2025年上证最佳北交所研究分析师第一名

2024年21世纪金牌分析师北交所研究第一名

2016-2022年水晶球奖北交所最佳分析师公募榜/总榜 双第一

2016-2017年金牛奖新三板研究第一名

2015-2016年新财富最佳新三板研究第一名

//

推 荐 阅 读

开源北交所研究精选| 次新股梳理

【开源北证医药生物】国办发文加码创新药支持，掘金北交所/新三板CRO与创新药标的No.11



免责声明 Disclaimers

《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施。通过微信形式制作的本资料仅面向开源证券客户中的金融机构专业投资者，请勿对本资料进行任何形式的转发行为。若您并非开源证券客户中的金融机构专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的信息。本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，还请见谅！感谢您给予的理解和配合。若有任何疑问，请与我们联系。

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。